

## POLYPHOS SERIES – DP Laser-Depaneling

## POLYPHOS SERIES – CT Laser-Cutting



### ASYS setzt in Sachen Laserkompetenz neue Maßstäbe

ASYS präsentiert mit den Nutzentrennersystemen eine umfassende Produktlinie, vom halbautomatischen Einsteigermodell bis hin zum High-End Inlinesystem. Die ergonomisch gestalteten POLYPHOS CT 7000, POLYPHOS DP 8000 und 9000 Serien sind mit der neuesten Lasertechnologie ausgestattet. Bei der Entwicklung wurde ein besonderer Schwerpunkt auf Sicherheit, einfache Bedienung und eine reduzierte Stellfläche gelegt.

Die **POLYPHOS 7000 Serie** ist eine für das Laserschneiden von Metallkern-Leiterplatten bzw. IMS (Integrated Metal Substrate) geeignete Maschinenplattform. Eingesetzt wird sie zum Beispiel in der Produktion von LED-Leuchten oder bei keramischem Trägermaterial von Leistungshalbleitern auf DCB-Substraten. Im Gegensatz zu der POLYPHOS 8000 Serie besteht das System aus einer CNC-gesteuerten Maschine mit einem Präzisions-Schneidkopf, um den Laserstrahl zu positionieren. Schneidgas unterstützt den Schneidprozess. Je nach Anwendung können verschiedene Gase verwendet werden. Eine Kamera wird zur Maschinenkalibrierung und Offset-Korrektur mithilfe von Fiducials eingesetzt.

Die **POLYPHOS DP 8000 Serie** setzt einen neuen Standard in Sachen Lasertrennen von starren und flexiblen Leiterplatten. Eine Basis aus Granit sorgt für ein Maximum an Stabilität und Präzision. Unterschiedliche Strahlquellen stehen zur Verfügung, um sich dem Material anzupassen. Die Anlage ist als manuell zu beladendes oder vollautomatisches Inline-System erhältlich. Für die Inline-Produktion sind mehrere produktspezifische Wärmeträgersysteme verfügbar. Eine Kamera wird zur Maschinenkalibrierung und Offset-Korrektur mithilfe von Fiducials eingesetzt. Die Anlage beinhaltet ein präzises XY-Achssystem und einen digitalen Galvo-Scanner, um einen Step&Scan Prozess und dadurch einen optimierten Durchsatz bei höchster Genauigkeit zu ermöglichen.

#### Features

- › Hohe Positioniergenauigkeit
- › DIN-sprachenkontrollierte (CNC) Schneidrezepte (POLYPHOS CT 7000 und DP 8x00)
- › Strahlquellen und Optiken für verbesserte Schneidergebnisse auf dem letzten Stand der Technik
- › Grafikeditor für Schneidrezepte (POLYPHOS DP 9000)

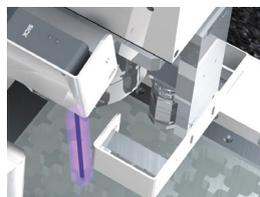
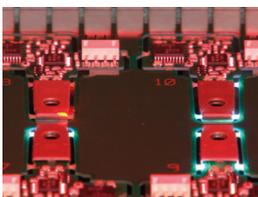
Die **POLYPHOS 9000 Serie** ist ein kosteneffizientes und durchsatz-optimiertes Laser-Nutzentrennsystem zum Trennen von elektronischen Schaltungsträgern mit einer Dicke von bis zu 1,6mm. Es ermöglicht flexible Automatisierungskonzepte dank verschiedener Wärmeträgeroptionen und Transportmöglichkeiten. Außerdem können diverse Bearbeitungsfelder realisiert werden, um unterschiedlichen Nutzengrößen und Genauigkeitsanforderungen zu entsprechen.

## ASYS GROUP

Besuchen Sie unsere Website.  
[www.asys-group.com](http://www.asys-group.com)

### Profitieren Sie von unseren Serviceleistungen

- › Hochqualifizierte Service Teams
- › 24 Stunden Service-Hotline
- › Kurze Reaktionszeiten
- › Weltweiter Wartungsservice, Bediener- und Prozessschulungen
- › Betreuung über Remote-Service
- › Weltweit flächendeckendes Service-Netzwerk



		POLYPHOS CT 7000	POLYPHOS DP 8000	POLYPHOS DP 8100	POLYPHOS DP 8200	POLYPHOS DP 9000	
Technik	Nutzenformate (max. LxB in mm) <sup>1</sup>	490x460	305x250	460x305	460x460	180x180 bis 245x245	
	Maschinendimensionen (LxBxH in mm) <sup>1</sup>	830x1565x1550	1090x1800x1455	1400x1800x1570	1400x1900x1570	700x1548x1685	
	Scanfeld		50x50 bis 80x80	50x50 bis 80x80	50x50 bis 80x80	180x180 bis 245x245	
	Galvo Scanner		✘	✘	✘	✘	
	Schneidkopf	✘					
	Geräuschpegel	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)	
	NC-Achsen	✘					
Strahlquelle	DPSS-Laser mit SHG	30 W	✘	✘	✘	○	
		40 W	○	○	○	✘	
	UV-Laser		○	○	○		
	CO <sub>2</sub> -Laser	150 W	○	○	○		
	QCW Faser Laser	150 W	✘				
		300 W	○				
Laserkategorie		1	1	1	1		
Substrat	Länge (in mm)	20 bis 508	20 bis 305	20 bis 460	20 bis 460	20 bis 360 / 20 bis 400	
	Breite (in mm)	20 bis 460	20 bis 250	20 bis 305	20 bis 460	20 bis 180 / 20 bis 245	
	Transportbreite (in mm)					20 bis 320	
	Dicke (in mm)	0,1 bis 1,6 (2,0)	0,1 bis 1,6 (2,0)	0,1 bis 1,6 (2,0)	0,1 bis 1,6 (2,0)	0,1 bis 1,6 (2,0)	
	MCPCB/IMS (Metallkern-LP)	QCW Faser Laser	✘				
		Keramik (AlN, Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	✘				
FR4 1.6mm	DPSS-Laser mit SHG		✘	✘	✘	✘	
ESD Adapter	Produktspezifische Waren- träger und Handlingsysteme verfügbar						
	Ionisierung	○	○	○	○	○	
	Fiducial-Erkennung	✘	✘	✘	✘	✘	
	„Schlecht“ Markenerkennung	○	○	○	○	○	
Vision	Code Read	○	○	○	○	○	
	Handscanner	○	○	○	○	○	
	Automatischer Scanner	○	○	○	○	○	
DB & MES	„Gut/Schlecht“ Interface	○	○	○	○	○	
	Produktionsdatenverwaltung	○	○	○	○	○	
	Traceabilityfunktion	○	○	○	○	○	
	Segmentierter Transport	○	○	○	○	○	
Auslauf	Warenträgertransport	○	○	○	○	○	
	Tür	✘	✘	✘	✘		
Qualität	Techn. Verfügbarkeit ≥ 98 %	○	○	○	○	○	
	CE Erklärung	✘	✘	✘	✘	✘	
	MFU	✘	✘	✘	✘	✘	
	Schalldruckpegelmessung	✘	✘	✘	✘	✘	
	Stressuntersuchung	○	○	○	○	○	
	Prozessfähigkeitsuntersuchung	○	○	○	○	○	

✘ Standard  
○ Option

<sup>1</sup> Andere Dimensionen auf Anfrage

MFU = Maschinenfähigkeitsuntersuchung

Alle aufgeführten Informationen sind allgemeine Beschreibungen und Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in dargestellter Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Verbindlich sind lediglich die im Vertrag vereinbarten Leistungsbeschreibungen. Printed in Germany